



2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年8月7日

上場会社名 テクノクオーツ株式会社 上場取引所 東
コード番号 5217 URL <https://www.techno-q.com>
代表者(役職名) 取締役社長 (氏名) 園田育伸
問合せ先責任者(役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 麻田俊弘 (TEL) 03-5354-8171
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 無
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第1四半期の連結業績(2024年4月1日~2024年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第1四半期	4,785	19.1	1,151	52.7	1,220	51.3	822	26.5
2024年3月期第1四半期	4,019	△13.1	754	△24.3	806	△30.7	649	△16.9

(注) 包括利益 2025年3月期第1四半期 1,122百万円(43.3%) 2024年3月期第1四半期 782百万円(△30.9%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第1四半期	212.67	—
2024年3月期第1四半期	168.05	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年3月期第1四半期	25,643	19,773	77.1
2024年3月期	25,753	19,154	74.4

(参考) 自己資本 2025年3月期第1四半期 19,773百万円 2024年3月期 19,154百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年3月期	—	0.00	—	130.00	130.00
2025年3月期	—	—	—	—	—
2025年3月期(予想)	—	—	—	—	—

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2. 当社は、2024年10月1日付でジーエルサイエンス株式会社と共同持株会社設立による経営統合を行う予定であるため、2025年3月期の期末配当については現時点では未定であります。

3. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日~2025年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	18,000	5.5	3,720	2.9	3,690	△3.9	2,610	△4.4	675.00

(注) 1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

2. 当社は、2024年10月1日付でジーエルサイエンス株式会社と共同持株会社設立による経営統合を行う予定であります。業績予想については、現在の当社組織を前提に算定しており、共同持株会社の業績予想については、改めて発表する予定です。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 有

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料P. 7「2. 四半期財務諸表及び主な注記 (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 (会計上の見積りの変更)」をご覧ください。

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

2025年3月期1Q	3,900,000株	2024年3月期	3,900,000株
2025年3月期1Q	33,424株	2024年3月期	33,345株
2025年3月期1Q	3,866,590株	2024年3月期1Q	3,866,714株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等へのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況	2
(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(会計上の見積りの変更)	7
(追加情報)	7
(セグメント情報等の注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9
3. 補足情報	10
(1) 生産、受注及び販売の状況	10

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、物価上昇による実質賃金の減少等に伴い個人消費が停滞している一方、好調な企業収益を背景に雇用・所得環境の改善や設備投資拡大の動きは継続しており、景気は回復基調にあります。しかしながら、不安定な国際情勢の中、原材料価格やエネルギー価格の高騰、円安傾向の継続、世界的な金融引き締めによる景気停滞リスクの高まり等、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループが属する半導体業界におきましては、パソコンやスマートフォン向け需要の減退により、メモリー在庫の滞留が続いていますが、一方で生成AI分野の需要拡大を背景に、国内外における先端半導体の製造工場の新設や増設といった、今後を見据えた積極的な設備投資が相次いで計画・実行されており、半導体市場は引き続き着実な拡大が見込まれております。

以上のような環境の中、当社では、競争力強化のため高付加価値製品の開発と拡張によるマーケットの拡大、国内の増産体制構築のための準備等を行い、さらなる成長に向けて邁進しております。足元の受注高及び売上高は回復基調にあり、受注残高は引き続き高水準を維持する見込みです。

この結果、売上高は4,785百万円（前年同期比19.1%増）、営業利益は1,151百万円（前年同期比52.7%増）、経常利益は1,220百万円（前年同期比51.3%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は822百万円（前年同期比26.5%増）となりました。

当社グループの事業は、半導体事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に記載された区分ごとの状況の分析は省略しております。

(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ110百万円減少し25,643百万円となりました。主な要因は棚卸資産が550百万円増加し、現金及び預金が430百万円、電子記録債権が178百万円それぞれ減少したこと等であります。

負債合計は前連結会計年度末に比べ729百万円減少し5,870百万円となりました。主な要因は借入金が228百万円、未払法人税等が354百万円、賞与引当金が171百万円それぞれ減少したこと等であります。

純資産合計は前連結会計年度末に比べ619百万円増加し19,773百万円となりました。主な要因は利益剰余金が319百万円、為替換算調整勘定が299百万円それぞれ増加したこと等であります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,994,587	3,563,612
受取手形	237	1,183
電子記録債権	1,543,424	1,365,017
売掛金	3,944,653	4,037,674
製品	608,911	728,657
仕掛品	2,042,156	2,173,460
原材料及び貯蔵品	3,479,495	3,779,048
その他	467,634	293,055
貸倒引当金	△2,598	△2,773
流動資産合計	16,078,500	15,938,936
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,706,031	3,711,009
機械装置及び運搬具（純額）	3,505,094	3,454,872
土地	1,351,309	1,381,657
リース資産（純額）	136,625	125,603
建設仮勘定	174,951	236,960
その他（純額）	224,212	216,643
有形固定資産合計	9,098,224	9,126,746
無形固定資産	277,148	283,191
投資その他の資産		
その他	299,704	294,615
投資その他の資産合計	299,704	294,615
固定資産合計	9,675,077	9,704,552
資産合計	25,753,577	25,643,489

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
負債の部		
流動負債		
電子記録債務	330,761	223,377
買掛金	319,984	373,503
短期借入金	2,037,349	1,921,990
未払法人税等	613,072	258,651
賞与引当金	294,651	123,385
その他	589,957	532,805
流動負債合計	4,185,776	3,433,713
固定負債		
長期借入金	1,877,637	1,764,749
役員退職慰労引当金	44,400	46,389
退職給付に係る負債	208,425	217,726
その他	283,214	407,633
固定負債合計	2,413,676	2,436,498
負債合計	6,599,452	5,870,211
純資産の部		
株主資本		
資本金	829,350	829,350
資本剰余金	1,015,260	1,015,260
利益剰余金	15,917,933	16,237,563
自己株式	△41,215	△41,663
株主資本合計	17,721,329	18,040,511
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,453	3,980
為替換算調整勘定	1,429,341	1,728,786
その他の包括利益累計額合計	1,432,795	1,732,766
純資産合計	19,154,124	19,773,278
負債純資産合計	25,753,577	25,643,489

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
売上高	4,019,042	4,785,352
売上原価	2,816,490	3,146,641
売上総利益	1,202,551	1,638,711
販売費及び一般管理費	448,147	486,815
営業利益	754,404	1,151,895
営業外収益		
受取利息	137	104
受取配当金	510	570
為替差益	46,555	78,429
その他	10,797	2,344
営業外収益合計	58,001	81,448
営業外費用		
支払利息	5,640	11,165
その他	11	1,745
営業外費用合計	5,651	12,910
経常利益	806,753	1,220,433
特別利益		
固定資産売却益	118	-
国庫補助金受贈益	153,230	-
特別利益合計	153,348	-
特別損失		
固定資産除却損	172	310
特別損失合計	172	310
税金等調整前四半期純利益	959,930	1,220,123
法人税、住民税及び事業税	232,106	250,770
法人税等調整額	78,040	147,058
法人税等合計	310,146	397,828
四半期純利益	649,783	822,294
親会社株主に帰属する四半期純利益	649,783	822,294

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
四半期純利益	649,783	822,294
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,920	526
為替換算調整勘定	131,196	299,445
その他の包括利益合計	133,117	299,971
四半期包括利益	782,900	1,122,266
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	782,900	1,122,266

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(会計上の見積りの変更)

(棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げにおける見積りの変更)

これまで当社グループでは、一定の期間を超えて保有する棚卸資産については、帳簿価額を切り下げた価額をもって連結貸借対照表価額としてきました。

しかしながら、半導体業界における棚卸資産の保有期間が変化する中で、当社グループの棚卸資産の保有期間も変化してきており、また、一定期間を超えて保有する棚卸資産を評価するための十分なデータも蓄積されてきたことから、当第1四半期連結会計期間より、帳簿価額の切り下げ額を評価する方法を変更致しました。

この変更により、従来の方と比べて、当第1四半期連結累計期間の売上原価は177百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が同額増加しております。

(追加情報)

(当社とジーエルサイエンス株式会社の株式移転による経営統合及び持株会社体制への移行について)

当社及びジーエルサイエンス株式会社（以下「ジーエルサイエンス」といいます。）は、2024年5月10日に開催した取締役会にて、共同株式移転（以下「本株式移転」といいます。）の方法により2024年10月1日（以下「効力発生日」といいます。）をもって、両社の完全親会社となるジーエルテクノホールディングス株式会社（以下「共同持株会社」といいます。）を設立し経営統合を行うこと（以下「本経営統合」といいます。）について決議し、両社間で経営統合契約書を締結するとともに、本株式移転に関する株式移転計画（以下、「本株式移転計画」といいます。）を共同で作成いたしました。

なお、本株式移転計画は、2024年6月21日に開催された当社の定時株主総会において承認されております。

1. 本経営統合の目的

多様な販売先を有し、マクロトレンドに左右されにくく、グループの収益を安定的に支える強固な事業基盤を有するジーエルサイエンスと、今後更に高い市場の成長が期待され、ニッチな領域で地位を確立している当社を中核とする企業グループとして、両社それぞれ及びグループ全体が更なる飛躍を遂げ、企業価値の向上を実現してまいります。具体的には、本経営統合により、以下の施策・効果を実現することができると考えております。

(1) グループ戦略機能の強化と経営資源配分の最適化による成長機会の捕捉

両社を取り巻く環境は刻一刻と変化している中、今後の持続的な企業価値向上を実現していくにあたっては、グループ全体における経営資源配分の最適化が重要と考えております。従前から両社が独立した立場でそれぞれ意思決定をしており、また、上記のとおり安定的な事業基盤を持つジーエルサイエンスと、シリコンサイクルによる景気循環の影響を受ける当社という構造から、グループ全体としての成長に向けた投資、最適な資源配分に関して改善の余地があったと認識しております。本経営統合により、両社の事業上の特徴を踏まえたグループ全体の成長を実現する経営資源配分が可能となり、成長分野に対して積極的な投資が可能になると考えております。

(2) 管理機能の集約等による経営効率の向上

本経営統合を通じて、両社が共同持株会社の傘下に並列で位置付けられることで、これまで実現し得なかった人事交流、多様な人材登用やキャリア形成の機会の提供、経営理念の更なる浸透が図られ、グループ全体として適材適所の人員配置が可能になるとともに、両社に共通する機能を共同持株会社に集約することで、業務の効率化と品質向上を実現できると考えております。

(3) 各利害関係者に対する提供価値の最大化と意思決定の迅速化

グループ戦略機能を持つ共同持株会社のもと、両社がシナジーを發揮し、グループ全体の成長のために邁進することで、株主、取引先、従業員をはじめとする利害関係者に対して提供価値の最大化を図ってまいります。

なお、構造的に利益相反の問題が生じ得る親子上場問題に関しては、コーポレート・ガバナンス上の課題としてこれまでも議論してまいりましたが、両社の経営資源の相互活用については、ジーエルサイエンスと当社

少数株主との利益相反の懸念、当社の独立性確保の観点から、迅速かつ円滑にその推進を行うことに今後一定の制約や限界が発生するリスクが存在し得ると認識しております。本経営統合を通じて、共同持株会社にグループ全体の経営戦略の策定機能を持たせることで、経営戦略の策定と事業の執行を分離することとあわせて、当社及びジーエルサイエンスに事業に関する意思決定権限を委譲するとともにグループ内外の利害関係を一致させることで、迅速な意思決定とグループとしての経営資源の共有によるシナジー効果を追求できる体制を構築していくことが可能であると考えております。

2. 持株会社体制への移行の要旨

(1) 本株式移転のスケジュール

経営統合に関する基本合意書承認取締役会（両社）	2024年2月9日（金）
経営統合に関する基本合意書締結（両社）	2024年2月9日（金）
定時株主総会基準日（両社）	2024年3月31日（日）
経営統合契約書及び株式移転計画承認取締役会決議（両社）	2024年5月10日（金）
経営統合契約書締結及び株式移転計画作成（両社）	2024年5月10日（金）
株式移転計画承認定時株主総会（当社）	2024年6月21日（金）
株式移転計画承認定時株主総会（ジーエルサイエンス）	2024年6月25日（火）
東京証券取引所最終売買日（両社）	2024年9月26日（木）（予定）
東京証券取引所上場廃止日（両社）	2024年9月27日（金）（予定）
統合予定日（共同持株会社設立登記日）	2024年10月1日（火）（予定）
共同持株会社株式上場日	2024年10月1日（火）（予定）

(注) 上記は現時点での予定であり、本経営統合及び本株式移転の手續の進行上の必要性その他事由により必要な場合には、両社による協議の上、日程を変更することがあります。

(2) 本株式移転の方式

当社及びジーエルサイエンスが、両社を株式移転完全子会社、新たに設立する共同持株会社を株式移転設立完全親会社とする共同株式移転となります。

(3) 本株式移転に係る割当ての内容

	ジーエルサイエンス	当社
株式移転比率	1.00	2.10

(注1) 本株式移転に係る株式の割当ての詳細

ジーエルサイエンスの普通株式1株に対して共同持株会社の普通株式1株を、当社の普通株式1株に対して共同持株会社の普通株式2.10株を、それぞれ割当て交付する予定です。なお、本株式移転により、両社の株主に交付しなければならない共同持株会社の普通株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し1株に満たない端数部分に応じた金額をお支払いいたします。ただし、上記株式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社協議の上、変更することがあります。

(注2) 共同持株会社が交付する新株式数（予定）

普通株式：18,379,715株

上記は、ジーエルサイエンスの発行済株式総数11,190,000株（2024年3月31日時点）、当社の発行済株式総数3,900,000株（2024年3月31日時点）に基づいて算出しております。なお、当社及びジーエルサイエンスは、それぞれ、本株式移転の効力発生までに、現時点で保有し又は今後新たに取得する自己株式のうち実務上消却可能な範囲の株式を消却することを予定しているため、当社及びジーエルサイエンスが2024年3月31日時点でそれぞれ保有する自己株式（ジーエルサイエンス：930,260株、当社：33,345株）については共同持株会社の株式の割当てがなされることは予定しておりません。ただし、本株式移転の効力発生日までに実際に消却される自己株式数は現状において未確定であるため、共同持株会社が

発行する上記新株式数は変動することがあります。

(注3) 単元未満株式の取扱い等について

共同持株会社の単元株式数は、100株といたします。

なお、本株式移転により1単元(100株)未満の共同持株会社の株式の割当てを受ける両社の株主の皆様につきましては、かかる割当てを受けた株式を東京証券取引所その他の金融商品取引所において売却することはできませんが、そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆様は、会社法第192条第1項の規定に基づき、共同持株会社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、共同持株会社の定款において、共同持株会社に対し、自己の保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる旨の規定を設ける予定であるため、会社法第194条第1項及び定款の規定に基づき、共同持株会社に対し、自己の保有する単元未満株式の数と併せて1単元となる数の株式を売り渡すことを請求することも可能です。

(4) 本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社及びジーエルサイエンスは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

(5) 上場廃止となる見込み及び共同持株会社の上場申請等に関する取扱い

当社及びジーエルサイエンスは、新たに設立する共同持株会社の株式について、東京証券取引所にテクニカル上場を行う予定であります。上場日は、2024年10月1日を予定しております。また、当社及びジーエルサイエンスは本株式移転により共同持株会社の完全子会社となりますので、共同持株会社の上場に先立ち、2024年9月27日にそれぞれ東京証券取引所を上場廃止となる予定であります。なお、上場廃止の期日につきましては、東京証券取引所の各規則により決定されます。

3. 実施される会計処理の概要

本株式移転に伴う会計処理は、企業結合に関する会計基準における「共通支配下の取引等」に該当する見込みですが、詳細な会計処理については現時点において未定であります。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

当社グループは、半導体事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
減価償却費	263,978千円	279,438千円

3. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

当社グループは半導体事業の単一セグメントであります。

① 生産実績

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	4,902,292	+21.7

(注) 金額は販売価格によっております。

② 受注実績

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	6,701,101	+65.9	8,069,229	+11.9

③ 販売実績

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	4,785,352	+19.1